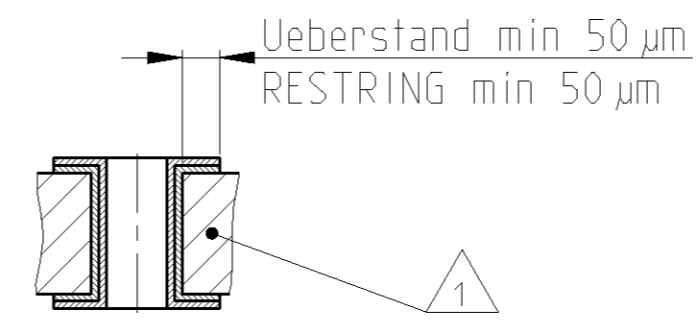
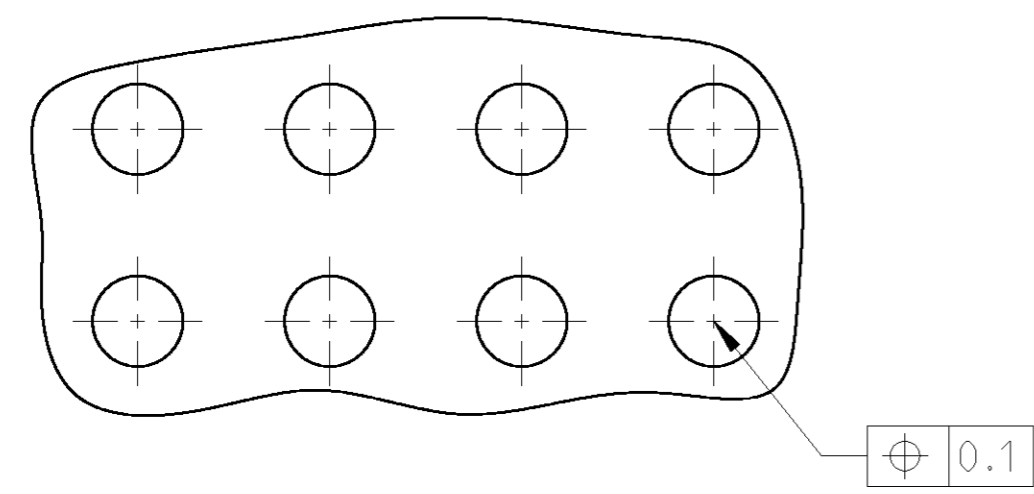


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. RELEASED FOR PUBLICATION FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG. 2009. DATED WITH: PASSEND ZU: BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. COPYRIGHT 2003

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A1	-						
PROJEKT NR.:							
		A		EGA0-2531-04	12NOV2004	MS	RJ
		B		SEE DMTEC	01JUN2005	SG	RJ
		B1		SEE DMTEC	16NOV2009	MS	TS

Lochaufbau in der Leiterplatte
HOLE CONSTRUCT FOR PCB



TE REV.	NEUFREIGABE/ÄND-LISTE-NR.	INDEX	BESCHREIBUNG	DATUM	NAME	M
A	ENA03T	a	fuer Produktion frei FOR PRODUCTION RELEASED	-	Fuenfs.	-
B	EGC95U	b	Ausführung B geändert. BMW Blatt 1 hinzu VERSION B CHANGED. BMW SHEET 1 ADDED			
B1	ENN24Y	g	BMW Blatt 2 von 3 hinzu. Version D,E und F fuer Multispring hinzu BMW SHEET 2 OF 3 ADDED. VERSION D, E AND F FOR MULTISPRING ADDED		Reeh	

Durchplatierte Bohrung Spezifikation
PLATING ACROSS OF HOLE SPEC. (B1)

Ausführung VERSION	A1	A2 ³	B	C1	C2	D	E1	E2
	SnPb (galvanisch / GALVANIC)	Au	Sn (chemisch / CHEMICAL)	Sn (galvanisch / GALVANIC) (oder/OR HAL)	Au	Sn (chemisch / CHEMICAL)	Sn (galvanisch / GALVANIC) (oder/OR HAL)	Au
Kupferschicht COPPER COATING	25 - 75 µm		30 - 55 µm	> 25 µm		30 - 55 µm	> 25 µm	
Zinn Schicht TIN COATING	4 - 15 µm	-	0.7 - 1.3 µm	5 - 15 µm		>= 1 µm	5 - 15 µm	
Gold Schicht GOLD COATING	-	0.05 - 0.2 µm ueber/OVER 1.3 - 5 µm Ni	-		0.05 - 0.2 µm ueber/OVER 2.5 - 5 µm Ni	-		0.05 - 0.2 µm ueber/OVER 2.5 - 5 µm Ni
Bohr Ø HOLE DIA.	1.15±0.025		1.125±0.03	1.15±0.025		1.1±0.03	1.6±0.025	
Platierter Ø PLATING DIA.	1.00 ^{+0.09} _{-0.06}		1.055 ^{+0.04} _{-0.06}	1.00 ^{+0.09} _{-0.06}		1.03 ^{+0.04} _{-0.06}	1.39 - 1.54	
Passend zu/SUITABLE TO Action-Pin Version TE: 1719087 BMW: 6 909 048.1 1/2	1, 2		1, 2, 3, 4	-		-	-	
Passend zu/SUITABLE TO Multispring Version TE: 1719087 Bl./SHEET 2 BMW: 6 909 048.1 1/2	-		-	1		2	3	

Bemerkungen
NOTES

- ¹ Leiterplatten Ausführung nach:
PRINTED CIRCUIT BOARD ACCORDING:
IEC 60249-2-4-TYP 60249-2-4-IEC-EP-GC-Cu
IEC 60249-2-5-TYP 60249-2-5-IEC-EP-GC-Cu
IEC 60249-2-11-TYP 60249-2-11-IEC-EP-GC-Cu
IEC 60249-2-12-TYP 60249-2-12-IEC-EP-GC-Cu
- ² Version B ist einzusetzen wenn nichts anderes spezifiziert ist
VERSION B IS BINDING TYPE IF NOTHING ELSE IS SPECIFIED
- ³ siehe BMW GS 95011-1. Pkt. 5.2.6
SEE BMW GS 95011-1. POINT 5.2.6
Ausnahmeregelungen sind mit der entsprechenden BMW Fachabteilung zu klären.
EXAPPTIONS HAS TO BE CLARIFIED WITH THE BMW SPECIFIED DEPARTEMENTS
- ⁴ Einpresskontakte siehe Zeichnung: TE 963964 / 965869
PRESS-FIT CONTACTS SEE DRAWING: BMW 1 383 753

BMW							
	DATUM	NAME	GESEHEN		DATUM	NAME	ARBEITSPAUSE
GEZ.	-	-	-	FERTIGG. GEPR.	-	-	-
GEPR.	-	-	-	WERKST. GEPR.	-	-	-
FUNKTION GEPR.	-	-	-	NORM GEPR.	-	-	-
ERSATZ FÜR:	-			ERSATZ DURCH:	-		
PART-NAME:	TABLE PIN CONTACT HOLE CONSTRUCT						SHEET 3 OF 11
BENENNUNG:	Tabelle Stiftkontakt Lochausführung						BLATT 3 V. 11
ERSTVERWENDUNG		HAUPTGR.		UNTERGR.		ZEICHNUNGS-NR./DRAWING-NO.	
TYP		E46		61		13 6 909 048	
FORMAT SIZE		2					

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSÄNDERUNG WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIS LETZTUELTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.				DWN	08SEP2004	tyco Electronics AMP GmbH	
				CHK	I.Sieler	D - 64625 Bensheim	
				APVD	R.Jetter	NAME	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)				PRODUCT SPEC		LOCHAUSFUEHRUNG FÜR EINPRESSKONTAKTE	
				108-18643		HOLE CONSTRUCT FOR PRESS-IN CONTACTS	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN				APPLICATION SPEC		-	
0 PLC ±				114-18279		SIZE	
1 PLC ±				WEIGHT		A2	
2 PLC ±				RESTRICTED CUSTOMER		/KUNDENZEICHNUNG	
3 PLC ±				SCALE MASSSTAB		10:1	
4 PLC ±				SHEET		1 OF 1	
ANGLES/WINKEL °				REV		B1	
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE				RESTRICTED TO		NUR FÜR BMW	
				DRAWING NO.		114-18645	
				ZEICHNUNGS-NR.		-	
				CAGE CODE		00779	